

半导体硅片激光切割氮化晶圆激光打孔异形切片来图定制

产品名称	半导体硅片激光切割氮化晶圆激光打孔异形切片来图定制
公司名称	北京华诺恒宇光能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:华诺激光 加工方式:激光切割加工 加工材质:半导体材料、硅片、晶圆
公司地址	北京市丰台区南三环西路88号花卉研究中心2102号
联系电话	13011886131

产品详情

硅晶圆切割是半导体芯片封装的常用加工工艺。激光切割的关键指标要求是高速和窄切割线。高频、高能量的红外脉冲光纤激光适用于这样的应用。

晶圆的厚度一般不超过250um，激光切割深度一般为晶圆厚度的1/3。